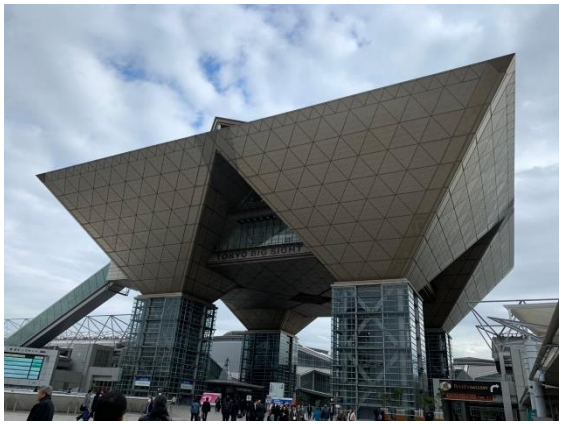
2020 年 3 月 18 日

群馬大学理工学部電子情報理工学科
情報通信システム第２研究室　学部４年
荻原　岳

SEMICON Japan 2019 参加報告

1.　イベント概要

SEMICON JAPAN 2019
開催期間：2019 年 12 月 11 日（水）-13 日（金）10:00-17:00
開催場所：東京ビッグサイト　西展示棟・南展示棟・会議棟



SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、 自動車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、 エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会である。およそ 700 社が最先端の製造技術を展示し、2 万 5000 人の参加者が、日本そして世界から集まる。次の時代に向けた大きな一歩を踏み出す原動力となる新しい出会いの場である。

展示会会場は「展示ゾーン」、「パビリオン・企画展示」、「地域パビリオン」と大きく 3 ブロックに分かれており、さらに工程別、種類別で分かれていた。

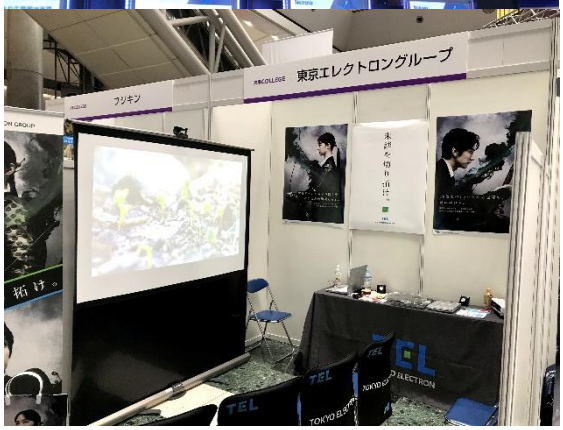
展示ゾーンでは、デバイスの設計、ウェーハ製造、ウェーハプロセスまでの「前工程ゾーン」、デバイス製造のその後である「後工程ゾーン」、デバイス製造に関連する部品や材料を展示する「部品・材料ゾーン」、最後に IoT の発展に大きく貢献している方々の出展である「Smart Applications ゾーン」に分かれており、展示の大部分を占めていた。

2.　参加報告

初参加となる SEMICON JAPAN 2019 では 12 月 13 日（金）に群馬大学小林研究室ブースの一画をお借りし、自身の研究に関するポスター発表を行った。学術的な展示を目的とした「ACADEMIA」スペースには、他にも東北大学や大阪大学など、全国より多数の大学が出展していた。群馬大学ブースには、小林研究室をご存知の方がお越しになり、自分の研究成果を知って頂くとともに研究室の近況などをお話しすることができた。なお、当日参加した数人で代わる代わる出展ブースを見て回り、業界の動向を見学して回った。

企業の出展スペースでは、半導体に関わる製品やサービスが展示されており、詳しく話を聞き、実際に製造工程で使用される機器の動作を確認できた。会場全体を出展スペースが占めており、また会場中央にて様々なセミナーが開催されており、半導体業界の大きさを知ることとなった。日頃の実験にて使用している測定機器を製造するメーカーも多数出展しており、より発展した製品を見ることができ、大変勉強になった。

就活生用に用意された「未来 COLLEGE」では、企業ごとにブースが設けられており、就活生向けに企業説明会が行われていた。半導体製造機器を開発する企業 24 社が出展しており、そのうち半導体研磨技術の「旭ダイヤモンド工業」、自動倉庫や無人搬送システムの「村田機械」、排ガス処理装置の「カンケンテクノ」、大手半導体製造装置メーカーの「東京エレクトロン」、半導体・液晶製造装置・印刷関連機器を手掛ける「SCREEN」の計 5 社の説明を聞いた。どの企業も各々の強みを持っていることが分かり、自分の就職したい分野や条件を見つける参考になった。



3.　謝辞

この度、SEMICON Japan 2019 へ参加の機会を与えてくださった小林春夫先生、参加に先立ち数々のご支援を頂いた桑名先生、群馬大学ブースにお立ち寄り頂いた皆様、さらに SEMICON Japan 2019 の運営に関係したすべての方々に深く感謝申し上げます。